

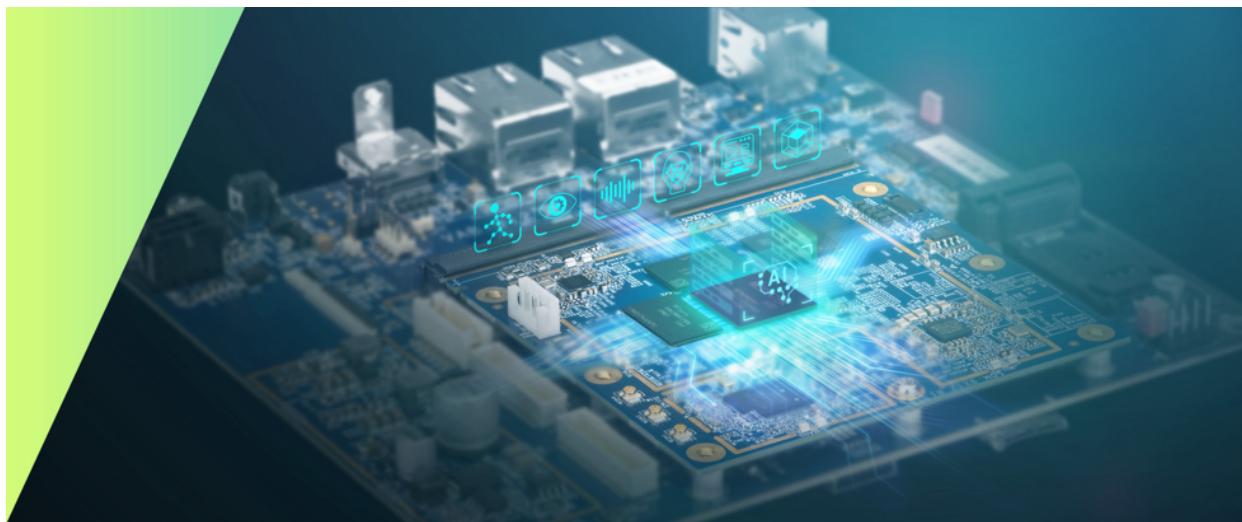


VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、「第 13 回 Japan IT Week 秋」において MediaTek Genio 1200 SoC を搭載した VIA SOM-9X12 モジュールを公開

2022 年 10 月 19 日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc. は、10 月 26~28 日に千葉県・幕張メッセで開催される「第 13 回 Japan IT Week 秋」において、MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC を搭載した VIA SOM-9X12 モジュールを公開いたします。本製品は、高度に統合された低消費電力プラットフォームと柔軟かつ豊富な接続性と I/O により、要求の厳しい産業・商業・民生向けにプレミアムエッジ AI システムおよびデバイスの開発を効率化を加速します。なお、「第 13 回 Japan IT Week 秋」における VIA ブースは、Hall 4 16-2 です。



VIA SOM-9X12 は、最大 2.2GHz 動作の 4 つの Cortex A78 プロセッサと、最大 2GHz 動作の 4 つの Cortex A55 プロセッサを統合した MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC を搭載。また、5 つの内蔵グラフィックスコアによる 3D グラフィックスや H.265 や H.264 などの UHD ビデオアクセスレーション、深層学習やニューラルネットワーク、コンピュータビジョンに対応した AI アクセラレーション機能も備えています。また、VIA VAB-912 キャリアボードを組み合わせることで、デュアル MIPI CSI カメラおよびデュアル MIPI DSI ディスプレイをサポートするほか、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、ギガビットイーサネット、およびオプションで 4G LTE 接続にも対応し、柔軟かつ豊富な I/O 拡張と高速接続オプションを提供します。これにより、産業・商業・民生向け用途における革新的なエッジ AI システムおよびデバイスを容易に開発することが可能となります。

VIA Technologies, Inc. の国際マーケティング担当 VP であるリチャード・ブラウンは、「VIA SOM-9X12 モジュールは、次世代 AIoT デバイスのコンセプト実証から量産への移行を加速するために必要なパフォ

VIA、「第 13 回 Japan IT Week 秋」において MediaTek Genio 1200 SoC を搭載した VIA SOM-9X12 モジュールを公開 2/3

一マンス、柔軟性、信頼性を提供します。また、豊富なカメラ、ディスプレイ、ネットワーク接続機能を備えた強力でスケーラブルなプラットフォームの採用により、お客様は、拡大が続くエッジ AI 市場において新たな機会を最大限に活用することができます」と述べています。

VIA SOM-9X12 モジュールについて

VIA SOM-9X12 は、高度なコンピューティング処理、コンピュータビジョン、マルチメディア機能を備えたプレミアムエッジ AI システムおよびデバイス向けに設計されています。また、オプションの VIA VAB-912 キャリアボードを使用することで、ソリューション開発のスピードアップを図ることができます。主な特徴は以下のとおりです。

- 2.0GHz MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC: 4 つの Cortex A78 @ 2.2GHz および 4 つの Cortex A55 @ 2.0GHz プロセッサ、深層学習、ニューラルネットワークおよびコンピュータビジョンアプリケーション向けの統合デュアルコア APU (AI Processor Unit) および先進の 3D グラフィックスに対応した 5 コアグラフィックスエンジンなどを搭載
- デュアル MIPI CSI カメラおよびデュアル MIPI DSI ディスプレイのサポート
- デュアルバンド 802.11ac Wi-Fi6、Bluetooth 5.2、ギガビットイーサネットなどの無線・有線ネットワーク接続に対応。オプションとして SIM カードスロットを統合した 4G LTE アダプタを用意
- USB 2.0 ポート × 3、USB 3.1 ポート × 3、M.2 B-key スロット × 1、MicroSD カードスロット × 1
- 16GB eMMC フラッシュメモリ、4/8GB システムメモリ
- SMARC 2.11 準拠の 82 × 80mm (3.22 × 3.15 インチ) モジュールフォーム・ファクター
- 146 × 102mm (5.75 × 4.17 インチ) の 3.5 インチ SBC キャリアボード
- Yocto 3.1 および Android 10 BSP

VIA SOM-9X12 モジュールの詳細については、下記 URL をご参照ください:

<https://www.viatech.com/en/products/boards/modules/via-som-9x12/> (英語)

本プレスリリースに関連する画像はこちらでご覧いただけます。

<https://www.viagallery.com/via-som-9x12/>

第 13 回 Japan IT Week 秋における VIA Technologies ブースについて

10 月 26 日～28 日まで千葉県・幕張メッセで開催される「第 13 回 Japan IT Week 秋」における VIA ブースは、Hall 4 16-2 です。本ブースでは、拡大するエッジ並びに車両向け VIA インテリジェント・ソリューションの最製品を展示いたします。詳細については、こちらをご覧ください。

<https://www.viatech.com/ja/about-ja/events-2022/via-at-japan-it-week-autumn/>

VIA、「第 13 回 Japan IT Week 秋」において MediaTek Genio 1200 SoC を搭載した VIA SOM-9X12 モジュールを公開 3/3

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、交通、産業およびスマートシティアプリケーション向けの革新的なスマートソリューションを通じ、ビジネスを高度な AI、IoT、コンピュータービジョンテクノロジーに接続するための国際的なリーダーです。台湾・台北に本社を置く VIA のグローバルネットワークは、米国、アジア、ヨーロッパのハイテクセンターとリンクし、世界をリードするハイテク、産業、運輸会社の多くを含む顧客に広がっています。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス: RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス: press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。